

EE Times Japan・EDN Japan特集

半導体後工程

「More than Moore」を支える新たな主役

2026年5月更新



AIや自動運転などの進化を支える上で、半導体の高性能化は不可欠になっている。

一方、半導体製造前工程では、プロセス微細化の難易度やコストが急速に高まっており、従来のように前工程だけで性能向上を実現することが難しくなっている。

そこで現在、半導体業界で存在感を高めているのが「後工程」だ。チップレット集積や2.5D／3D実装、先端パッケージ基板、高密度実装技術などを活用し、システム全体として性能を高める取り組みが加速している。後工程は今や、半導体の競争力を左右する重要領域になりつつある。

本特集では、半導体製造後工程に焦点を当てる。材料や製造装置、パッケージ基板、実装技術などを含め、後工程を支える最新技術やソリューション、市場動向を紹介する。

特集ページ：半導体後工程「More than Moore」を支える新たな主役



<https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/subtop/features/backend/>

掲載記事例

- [レゾナック主導「JOINT2」が大詰め 26年は140mm角基板に集中](#)
- [「ガラスの弱点」克服するコア基板 FICTが展示](#)
- [最大400mm角のパッケージを切断できるダイシングソー、ディスコ](#)
- [まるで「アメーバ」 多様な工法を組み合わせるチップレット実装受託サービス](#)
- [「Rapidusの隣」に光電融合パッケージ開発拠点、28年度の完成目指す](#)

キーワード

半導体製造後工程

アドバンストパッケージ

2.5D/3D実装

チップレット集積

光電融合

OSAT

協賛特典_タイアップ記事広告／リードジェン

特集

半導体後工程

「More than Moore」を支える新たな主役

EE Times Japan > 半導体後工程特集

Top Story

台湾企業と提携：
オキシサイドが半導体後工程向け装置事業を本格化

オキシサイドは2026年2月、レーザー微細加工装置メーカーである台湾Boliteとの業務提携に基本合意した。今回の合意に基づき両社は、半導体後工程に向けたレーザー微細加工装置事業を本格的に展開していく。

(2026年2月19日)

26年からの後工程委託に向け：
ロームが半導体製造でインド新興と協業、タタに続き

ロームがインドの新興半導体メーカーと製造で協業する。ロームは「ワーデバイスおよびIC製品について後工程の委託を検討。...」

(2026年2月20日)

① 貴社コンテンツ誘導枠

② 貴社ロゴ掲載

福田昭のデバイス通信 (507)
TSMCが解説する最新のパッケージング技術 (4)：
インターポザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

SEMICON Japan 2025：
「ガラスの弱点」克服するコア基板 FICTが展示

複雑の基板を貼り付けて切断：
最大400mm角のパッケージを切断できるダイシングソー、ディスコ

ZEMATES

RDL用フィルム型ポリイミドなど：
富士フイルムが後工程材料で新ブランド発表 売上高

25μm開隔で穴径は10μm以下：
半導体ガラス基板上にレーザー加工で微細穴 アスベクト

AIデータセンターに対応：
次世代AIチップレットで重要度が高まるインターコネ

ご協賛特典

①タイアップ記事・貴社支給コンテンツ（ホワイトペーパーや動画）へのリンクを特設誘導枠に無償掲載いたします

②タイアップ記事を制作いただいたご協賛社様は、貴社ロゴを無償掲載いたします。

※EE TimesJapan/EDN Japan、TechFactoryどちらのタイアップ記事でもロゴを掲載いたします

* ご留意事項

- 特設誘導枠と貴社ロゴ掲載は、1カ月間の期間掲載となります
- 特設誘導枠と貴社ロゴに関するレポート（クリック数など）は発行できません
- ページのデザインは企画やメディアによって異なるため、タイアップ記事へのリンクやロゴの掲載位置・仕様は、本ページのイメージと異なる場合があります。

PV保証タイアップ_認知向上施策

メディアのファンである読者のみを対象に誘導を実施するタイアップ記事です



掲載媒体

- EE Times Japan
- EDN Japan

※ いずれか選択

実施料金

¥1,700,000～ / 2,000PV

掲載媒体・保証PV数によって異なります、詳細は別途お問い合わせください

広告仕様

保証形態	PV保証
掲載期間	最短1週間～保証PV達成次第終了
仕様	産業テクノロジーメディア ・タイアップ記事 1本制作 ・取材あり ・約3,000～4,000字
レポート	PV、UB、平均滞在時間、外部リンククリック数、業種、職種、役職、閲覧企業名等
初校・念校の修正について	初校の出し直しの場合：¥300,000 念校以降の修正の場合：¥100,000 を別途申し受けます
備考	・誘導広告の位置／内容などはお任せいただきます (事前の確認・指定・終了後の開示はできません) ・撮影またはご提供いただいた画像は誘導アイコンに使用場合があります ・保証PV達成次第、誘導を停止します（最低1週間の誘導期間を保証します）

※ 価格はすべて税抜／グロス表記です

リード獲得施策概要

EE Times Japan・EDN Japan・TechFactory
読者・会員に誘導

貴社コンテンツに誘導

リード納品



獲得したリードは管理サイトで
ダウンロードできます（日次更新）



関心・専門性の
高い会員を誘導

EE Times Japan・EDN Japan、
TechFactory
を中心とする当社運営のエレ
クトロニクス業向けメディア
会員へメールで貴社コンテン
ツへ誘導いたします



ご協賛プラン

	プラチナプラン ¥1,600,000 (80万円OFF)	ゴールドプラン ¥1,000,000 (30万円OFF)	シルバープラン ¥600,000 (14万円OFF)
ご提供リード数 ・セグメント条件の設定はありません	200件保証	150件保証	80件保証
コンテンツ数	2本	2本	2本
タイアップ記事制作	1本		
ホワイトペーパーご支給 ※お手持ちのコンテンツをご用意ください	1本	2本	2本

※ 料金は税別、グロスです。
※ ホワイトペーパーをお持ちでない場合、別途費用が発生しますが制作プランがありますので、担当営業までご相談ください。
※ プランのカスタマイズも可能です。担当営業までご相談ください。
※ ご協賛状況により、実施見合わせとなる可能性がありますので、予めご了承ください。
※ リード獲得期間は2カ月間を想定しています

各種規定

本企画書掲載のアイティメディア商品のご提供に際しては、サービス基本規程・媒体規定・入稿基準・リー・キャンセル規定が他の条件に優先して適用されます。

以下のリンクからご参照ください。

- サービス基本規程

<https://promotion.itmedia.co.jp/terms/master>

- 媒体規定、入稿方法

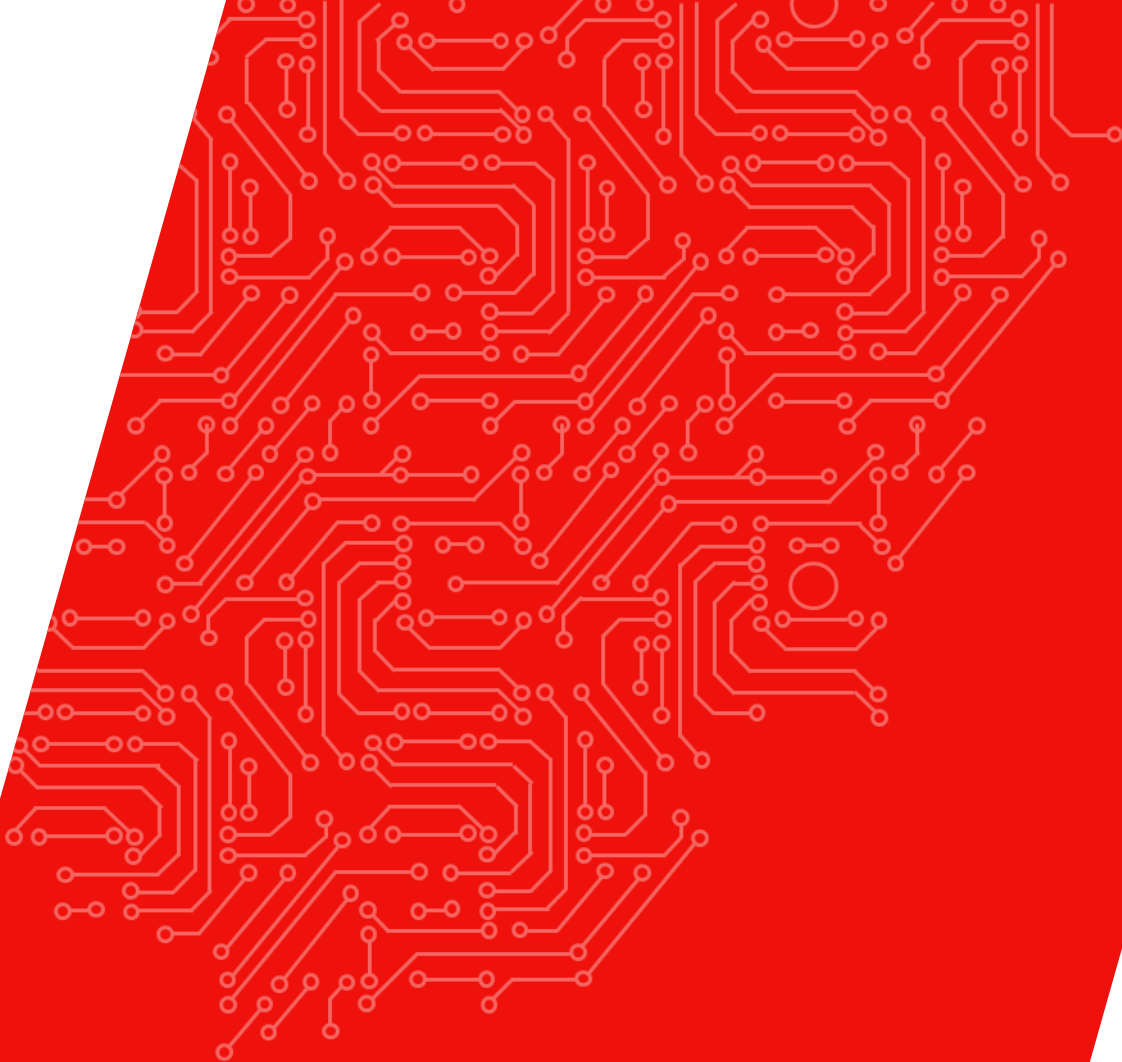
https://promotion.itmedia.co.jp/order_regulation

- リードジェネレーションサービスガイド

<http://go.itmedia.co.jp/l/291242/2020-07-01/mqtw22>

- キャンセル規定

<https://promotion.itmedia.co.jp/terms/cancellation>



■お問い合わせ

アイティメディア株式会社 営業本部

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12

紀尾井町ビル 13階

<https://promotion.itmedia.co.jp/contact>

